1

明細書

線状光源装置及びその製造方法、並びに、面発光装置

技術分野

本発明は、例えば、携帯電話、ディジタルカメラなどの液晶表示パネルのバックライトとして利用できる線状光源装置及びその製造方法、並びに、面発光装置に関する。

背景技術

第1の従来例の光源装置及び面発光装置は、例えば、図6及び図7に示すように、携帯電話やディジタルカメラなどの液晶表示部に敷設された幅広の下反射シート120と、下反射シート120の上面上に設けられ、その一方の側端部が下反射シート120の一方の側端部から突出した導光板121と、導光板121の側面に対峙して設けられた光源部122と、導光板121の発光面の端部、及び、光源部122を上方から覆うように設けられた上反射シート127とから構成されている。

光源部122は、導光板121の突出した端部の下面にその一部が配された配線基板としての細長い平板形状のフレキシブル基板123と、該フレキシブル基板123の上面に、導光板121の側面に近接して設けられた横長の直方体形状のケース124と、各ケース124に収納された発光素子(図示せず)と、ケース124に充填された透明の光透過性の樹脂封止層125とを備えている。

各ケース124の導光板121の側面に平行な面、即ち主光取出し面は開口されており、各ケース124の開口部から樹脂封止材が充填されて、各ケース124の開口部が樹脂封止材によって閉塞されている。さらに、各ケース124の側面には、発光素子導通用のリード端子126が導出され、リード端子126はフレキシブル基板123の配線パターンに半田付けによって電気的に導通接続されている。

そして、発光素子からの光が各ケース124の主光取出し面から出て導光板1

21に入射すると共に、ケース124の上面及び下面から漏れる光の成分を上反射シート127によって反射させて導光板121に入射させ、光を再利用することにより、導光板121の発光面の高輝度化を図っている。

また、第2の従来例の面発光装置として、例えば、図8及び図9に示すものが知られている。この面発光装置においては、発光素子132を収納する凹部131が導光板130の端部に設けられると共に、配線基板としての細長い平板状のフレキシブル基板133に搭載された発光素子132の主光取出し面が導光板130の発光面と同じ向きになるようにして、発光素子132が導光板130の凹部131内に設置されている。導光板130の発光面は、図中一点鎖線で描かれている液晶表示パネルに対峙している。また、発光素子132の周囲を封止すべく導光板130の凹部131に樹脂封止層134が形成されている。また、凹部131と同じ幅を有する上反射シート135が導光板130の発光面の端部上に設けられていると共に、上記凹部131を除いた導光板130の底面にドットパターン136が形成されている。

そして、発光素子132から放出される光の成分の一部が上反射シート135により導光板130の内部側に反射され、さらに、導光板130において、発光素子132からの光及び上反射シート135からの反射光がドットパターン136により拡散されることによって、導光板130の発光面において一様な輝度の発光が得られるようになっている。このような従来の発光素子の構造は、例えば特開2001-67917号公報の第3—6頁、図2及び図3に開示されている

解決課題

しかしながら、第1の従来例の面発光装置の場合、発光素子がケース124に収納されている構造を採っていることから、発光素子の光がケース124の上下左右の各壁面によって遮られている。その結果、発光素子の配光特性が狭くなってホットスポットの原因となり、輝度むらが発生しやすい。また、フレキシブル基板123の上に発光素子のリード端子126が半田付けされているため、面発光装置の高さ寸法A、が大きくなり、全体の薄型化が図れないという問題がある

しかも、発光素子が実装されたケース124をフレキシブル基板123上で半田付けしているため、実装精度を向上させるのが容易ではなく、発光素子の光軸を、ケース124の主光取出し面(導光板121の側面)に対して直交するように設けるのが容易ではなく、各ケース124に収納された発光素子の横方向の光軸の位置と、導光板121の側面の長手方向の中心線の位置とがずれ易く、導光板121への光取込み効率が低下するという問題がある。

さらに、フレキシブル基板 1 2 3 が導光板 1 2 1 の端部まで延設されているため、下反射シート 1 2 0 による反射が低減されてしまい、導光板 1 2 1 への光取込み効率がより低くなるという問題がある。

加えて、フレキシブル基板 1 2 3 の大きさによって、光源部 1 2 2 の設置スペースの幅寸法 B'が決定されるため、全体の小型化を図るのが難しいという問題がある。

また、発光素子の配向特性をケース124の側壁によって変えることには限度があるため、特に発光素子の使用数を削減した場合に、輝度むらが大きくなるという問題がある。

また、第2の従来例の面発光装置の場合、導光板130への光取込み効率を高くするには限度があり、面発光装置全体の光の利用効率が低いという問題があった。

さらに、発光素子132の光を上反射シート135に反射させるだけの空間を 必要とするため、全体を薄型にするには制限されるような場合もある。

発明の開示

本発明の主たる目的は、上述の問題点に鑑み、全体の小型化及び薄型化を図りつつ、輝度の向上、特に、発光素子の使用数に拘わらず、輝度の均一化や、輝度むらの低減を図りうる線状光源とその製造方法、及び、面発光装置の提供を図ることにある。

上記課題を解決するために、本発明の線状光源装置は、実装面を有する角棒状の配線基板と、配線基板の実装面上に長手方向に沿って所定の間隔をおいて配設

されてダイボンディングされた複数の発光素子と、配線基板の実装面上に各発光素子の両側に、且つ、各発光素子と交互に位置するように配置された複数の反射板とを備えている、そして、各反射板は発光素子を挟んで相対向する対向面を有しており、各反射板の対向面は、各発光素子の出射方向に向かうにしたがって開口面積が大きくなるように傾斜している。

この構造により、第1の従来例のように発光素子がケースに収納されるのではなく、発光素子が配線基板上に直接配置されているので装置の小型化が図られる。さらに、発光素子からの光が反射板によって拡散されながら放出されることになり、高輝度の線状光が得られるようになる。しかも、発光素子を挟む両側の反射板によって、光源部の配光特性の調整が容易に可能となり、発光素子の使用数に拘わらず光源部の長手方向の輝度の均一化が図れると共に、高輝度で且つ輝度むらが少なくなる。

なお、角棒状の配線基板には、厚みが若干大きなほぼ平板状の配線基板も含むものとする。

反射板の対向面の形状を、矩形状又は台形状のいずれかにすることにより、以下の利点が得られる。例えば、反射板の対向面の形状が矩形状の場合、発光素子から放出される光がほぼ直進することになり、幅小の線状光が得られる。一方、反射板の対向面の形状が台形状の場合、発光素子から放出される光が上下方向にやや拡散されることになり、やや幅広の高輝度な線状光が得られる。

光透過性の樹脂封止材を、配線基板の実装面と発光素子とその両側の反射板の対向面との間に形成される各凹部に充填してなる樹脂封止層をさらに備えることにより、凹部の空気層が排除されて発光素子からの光の取込み効率がよくなる。また、各発光素子の周囲が樹脂封止材によって覆われることになり、発光素子が周囲の環境から保護される。この樹脂封止層の形状としては、例えば、台柱形状、台錐形状、円錐台形状が好ましい。なお、これら立体形状の各側面が曲面(円弧、波形状、凹凸)である場合も含むものとする。

各樹脂封止層において、配線基板と各反射板とに亘る端面が鏡面化されていることにより、発光素子から放出される光が、鏡面化された樹脂封止層の断面に反射されて、線状光を放出する樹脂封止層の断面に向けて集光されることになり、

より高輝度の線状光が得られる。この樹脂封止層の断面の形状としては、例えば、台形状が好ましい。但し、台形状の斜辺が曲線であってもよい。

各樹脂封止層の各反射板の対向面の間に位置する部分の端面が各反射板の端面と実質的に1つの平面を構成していることにより、ほぼ線状の光源部が簡単に構成できる。この樹脂封止層の断面の形状としては、例えば、矩形状、楕円形状、トラック形状のいずれであってもよい。要するに、全体として、略線状の光源部を構成できる形状であればよい。

配線基板の実装面に隣接する長手方向の両端面から上記各反射板の対向面の先端部に亘る領域に設けられ、反射シート又は蒸着膜からなる反射部材をさらに備えることにより、配線基板の軸線に対して直交する放出される発光素子からの光が、反射シート又は蒸着膜からなる反射部材によって反射されて、線状光を放出する樹脂封止層の断面に集光されることになり、より高輝度の線状光が得られる

本発明の線状光源装置の製造方法は、配線基板の実装面上に、発光素子を所定の間隔をおいて配列してダイボンディングする工程(a)と、配線基板の実装面上に、発光素子の出射方向に向かうにしたがって開口面積が大きくなるように傾斜した対向面を有する反射板を、各発光素子の両側に配置する工程(b)と、工程(a)及び(b)の後で、光透過性の樹脂封止材を、配線基板の実装面と発光素子と反射板の傾斜面との間に形成される凹部に充填する工程(c)と、工程(c)の後で、反射板が各発光素子の両側に、且つ、各発光素子と交互に位置するようにダイシングすることにより角棒状の光源装置を切り出す工程(d)とを含んでいる。工程(a)と工程(b)とは、いずれを先に行なってもよい。

この方法により、全体形状が角棒状であることから薄型化及び小型化された機器の内部に容易に内装しうる線状光源装置が得られる。

工程(d)では、先端の断面が二等辺三角形状のブレードによって上記配線基板の裏側からダイシングを行なって、上記角棒状の光源装置の断面を台形状に加工することにより、高輝度な幅広の線状光を放出する線状光源装置が容易に得られる。

本発明の面発光装置は 配線基板と、配線基板に導通接続された発光素子と、

該発光素子からの光を取り込んで略全面を発光面とする導光板とを備え、発光素子は、配線基板にダイボンディングされ、さらに、発光素子の主光取出し面が導 光板の側面に対して平行に取り付けられている。

この構造により、第1の従来例のように発光素子がケースに収納されることなく配線基板上に直接配置されているので、発光素子から導光板の側面に向かって放出される光が導光板に直接取り込まれ易くなり、発光強度が減衰されることなく高効率で発光素子からの光を導光板に入射できることになる。

発光素子の主光取出し面の中心の位置と、導光板の側面の長手方向の中心線の位置とが同一高さであることにより、最も輝度の高いとされる発光素子からの光が導光板の側面を突き進むことになり、導光板への光取込み効率がより一層高くなる。

配線基板は、導光板の厚みに合わせて角棒状に加工されており、配線基板の長手方向の軸線が導光板の側面に対して平行であることにより、導光板の厚さが全体の厚さを決定することになり、面発光装置の薄型化が図れると共に、配線基板が角棒状であるため、配線基板の設置スペースが小さくなり、全体の小型化が図れるようになる。

以上説明したように、本発明の線状光源装置によれば、複数の発光素子を、細長い角棒状の配線基板の長手方向に沿って所定の間隔をおいて配設されてダイボンディングするようにしたので、実装精度に関係なく各発光素子の配光特性を広くとれる。しかも、該各発光素子の両側に、且つ、各発光素子と交互に位置するように反射板を配設し、両反射板の対向面を、各発光素子の出射方向に向かうにしたがって開口面積が大きくなるように傾斜したため、各発光素子間の光が重なるように拡散できる。

また、反射板の対向面の形状を、矩形状又は台形状のいずれかにするようにしたので、線状光の幅を容易に変更できる。

さらに、光透過性の樹脂封止材を、配線基板の実装面と、発光素子と、両反射板の対向面とによって形成される凹部に充填して樹脂封止層を形成するようにしたので、輝度の向上と、発光素子の保護とを実現するのに有効である。

加えて、各樹脂封止層において、配線基板と両反射板とで形成される部位に位

置する断面を鏡面化したり、両反射板の対向面の間に位置する断面を同一面に位置させたりすることにより、光の取込み効率のよい線状の光源部を簡単に構成できる効果がある。

さらに、反射シート又は蒸着膜からなる反射部材を、配線基板の実装面に隣接 する長手方向の両端面から各反射板の対向面の先端部にかけての領域に設けるこ とで、より高輝度の線状光を得ることができる。

また、本発明の線状光源装置の全体の形状を、角棒状に加工するようにしたので、薄型化及び小型化された携帯電話やディジタルカメラなどの収納部に容易に内装できる。

さらに、角棒状の線状光源装置の断面を台形状に加工すれば、幅広の線状光を 放出でき、輝度を向上させるのに効果的である。

そして、本発明の面発光装置によれば、発光素子をダイボンディングして細長 い角棒状の配線基板に実装すると共に、ダイボンディングされた発光素子の主光 取出し面を導光板の側面に対して平行するようにしたため、導光板への光取込み 効率を向上することができる効果がある。

また、発光素子の主光取出し面の中心の位置と、導光板の側面の長手方向の中心線の位置とを同じ高さになるように設け、最も輝度の高いとされる発光素子からの光を導光板の側面から取り込むようにしたので、導光板の発光面の輝度が向上するのに有効である。

さらに、配線基板を導光板の厚みに合わせて角棒状に加工すると共に、配線基板の軸線を導光板の側面に対して平行するように配すれば、全体の薄型化、及び、全体の小型化を図るのに効果的である。

図面の簡単な説明

図1Aは、本発明の第1の実施形態に係る線状光源装置の斜視図、図1Bは、 反射シートが設けられた線状光源装置の縦断面図、図1Cは、蒸着膜が設けられた線状光源装置の縦断面図である。

図-2 A は、第 1 の実施形態の複数の発光素子が配線基板に配設された状態の斜視図、図 2 B は、発光素子がダイボンディングされた状態の斜視図、図 2 C は、

反射体が配線基板に貼着された状態の斜視図、図2Dは、図2Cの一部を拡大した状態の斜視図、図3Eは、樹脂封止材が充填された状態の斜視図、図2Fは、ダイシングされる状態の斜視図である。

図3Aは、第1の実施形態における先端部の形状が二等辺三角形のブレードによって配線基板の裏側からダイシングされる状態の側断面図、図3Bは、樹脂封止層が台錐形状の線状光源の斜視図、図3Cは、図3Bの縦断面図である。

図4は、本発明の第2の実施形態に係る面発光装置の斜視図である。

図5は、発光素子の実装部分を、導光板とプリント基板の取付け構造と共に示す要部の縦断面図である。

図6は、第1の従来例の面発光装置の斜視図である。

図7は、第1の従来例の発光素子の実装部分を、導光板とフレキシブル基板の取付け構造と共に示す要部の縦断面図である。

図8は、第2の従来例の面発光装置の一部を切欠いて示す側面図である。

図9は、第2の従来例の発光素子の実装部分を、導光板とフレキシブル基板の取付け構造と共に示す要部の縦断面図である。

最良の実施形態

本発明を実施するための最良の形態として、以下の第1の実施形態及び第2の 実施形態につき、図1~図5を参照しながら説明する。

本発明の第1の実施形態の線状光源装置においては、複数の発光素子を、細長い角棒状の配線基板の長手方向に沿って配設し、各発光素子の両側に、各発光素子と交互に位置するように反射板を配置している。しかも、両反射板の対向面を、各発光素子の出射方向に向かうにしたがって開口面積が大きくなるように傾斜させている。さらに、配線基板、発光素子、両反射板の間に形成される凹部に光透過性の樹脂封止材を充填し、該凹部における空気層を排除している。加えて、配線基板の実装面に隣接する端面から反射板の先端部にかけての領域を、帯状の反射部材によって被覆している。さらに、反射板の先端部間に位置する樹脂封止層の矩形状の端面を同一平面に位置させている。以上のような構造により、高輝度で且つ輝度むらの少ない線状の光源を得るようにしている。

図1Aは本発明の第1の実施形態に係る線状光源装置の斜視図、図1Bは反射シートが設けられた線状光源の縦断面図、図1Cは、蒸着膜が設けられた線状光源の縦断面図である。

図2A~図2Fは本発明の第1の実施形態に係る線状光源装置の製造工程を示す斜視図である。図2Aは複数の発光素子が配線基板に配設された状態の斜視図、図2Bは発光素子がダイボンディングされた状態の斜視図、図2Cは、反射体が配線基板に貼着された状態の斜視図、図2Dは図2Cの一部を拡大した状態の斜視図、図2Eは、樹脂封止材が充填された状態の斜視図、図2Fは、ダイシングされる状態の斜視図である。

図3Aは先端部の形状が二等辺三角形のブレードによって配線基板の裏側からダイシングされる状態の縦断面図、図3Bは樹脂封止層が台錐形状の線状光源の斜視図、図3Cは図3Bの縦断面図である。

図1~図3に示すように、第1の実施形態の面発光装置は、細長い角棒状の配線基板としてのプリント基板4と、該プリント基板4上に所定の間隔をおいて配置された複数の発光素子5と、該各発光素子5の左右両側に形成された反射板6と、該反射板6及びプリント基板4の間に形成される台形柱状の凹部7に充填された光透過性の樹脂封止層10と、プリント基板4の上面及び下面から反射板6の先端部にかけて貼着された反射部材としての帯状の反射シート101を備えている。

図1Aに示すように、プリント基板4は、図2Aに示す平面視で四角形状のプリント基板40から、ダイシングによって細長く角棒状に形成されたものであり、その実装面上には、複数の発光素子5が、細長い角棒状のプリント基板4の長手方向に沿って所定の間隔をおいて一列に配設されている。さらに、プリント基板4の両端部からは、各発光素子5に通電するための+及び一の電極端子がそれぞれ導出されている(図示せず)。

発光素子5は、例えば、GaN系化合物半導体を利用した白色発光機能を有するものであって、透明のサファイア基板上にエピタキシャル成長されたn型層及びp型層のそれぞれの上面上に、n型電極及びp型電極が形成されている。該両電極は、ワイヤ9によって、プリント基板4の配線パターンにダイボンディング

され、蛍光体を含有する透明樹脂で被覆された各発光素子 5 が電気的に直列接続 されている。

反射板 6 は、図2 D に示すように、複数の台形柱状及び山形状の突条体 6 1、6 2 を有する反射体 6 0 が、図1 A に示すように、発光素子 5 の両側に、且つ、各発光素子 5 と交互に位置するように板状にダイシングされている。そして、ダイシングされた反射板 6 の厚み寸法と、細長い角棒状のプリント基板 4 の厚み寸法とが実質的に同一の寸法になっている(例えば、0.3~1.0 mmの範囲内で)。さらに、各発光素子 5 の両側に位置する反射板 6 の傾斜面(対向面)6 a 6 a が、発光方向に向かうにしたがって開口面積が大きくなるように形成されているので、各発光素子 5 の光が反射板 6 の傾斜面 6 a 。6 a に反射され、且つ、拡散されながら発光することになる。したがって、輝度の乏しい各発光素子 5 の間においては、拡散された各発光素子 5 の入射光が重なり合うことで、輝度ができるだけ均一化される。この反射板 6 の傾斜面 6 a 。6 a の形状は矩形状で、その傾斜角度は、輝度むらが最も小さくなるように適宜調整することが可能である。

樹脂封止層10は、凹部7にエポキシ樹脂などの透明の樹脂封止材が充填されることによって形成されている。そして、この樹脂封止層10が、プリント基板4,発光素子5及び反射板6の間に形成されている凹部7に注入充填されると、樹脂封止材によって凹部7の空気層は排除されるので、発光素子5からの光の取込み効率がよくなる。

さらに、樹脂封止層10は、台形柱状を呈し、発光素子5を有するプリント基板4の実装面と同一形状の端面と、両反射板6の傾斜面6a, 6aと同一形状の端面と、プリント基板4の端縁部と両反射板6の傾斜面6a, 6aの端縁部とで形成される部位に位置する台形状の端面と、両反射板6の傾斜面6a, 6aの先端部間に形成される矩形状の端面とを有している。さらに、各樹脂封止層10の台形状の端面は鏡面化されて反射効率がよくなると共に、各樹脂封止層10の矩形状の端面は狭幅のほぼ共通の一平面を形成しているので、実質的に線状の発光面が形成されることになる。

反射シート101は、鏡面状のテープ、又は、白色などの光反射率の高い材料

からなるテープ状のものであり、この反射シート101により、プリント基板4の実装面に隣接する端面(上面及び下面)から反射板6の傾斜面6a,6aの先端部にかけての領域が覆われている。このため、発光素子5から上下方向に放出する光がほぼ余すことなく両反射シート101で反射されてから前方に集光され、発光面から線状に発光されることになる。

次に、線状光源装置の使用態様について説明する。プリント基板4の配線パターンを介して各発光素子5が通電されると、各発光素子5の半導体層の中の活性層から光が放出される。活性層からの光は、発光素子5の主光取出し面、即ちワイヤ9がダイボンディングされた電極が形成されている面から放射状に放出される。

発光素子5から放出される光のうち、上下方向に放出された光は、反射シート101によって反射されて前方へ進み、前方向に放出された光はそのまま直進し、左右方向に放出された光は、両側の反射板6の傾斜面6a,6aによって反射されると共に、拡散されて前方へ進むことになる。このように、左右方向に放出された光が拡散されることにより、各発光素子5の間の輝度が補間されて輝度の均一化が図れる。さらに、各発光素子5が樹脂封止されているので、光の取込み効率が高くなり、輝度が向上する。

次に、線状光源装置の製造方法について、図2A~図2Fを参照しながら説明する。図2Aに示す工程の前に、プリント基板4Oとして、例えば、白色のガラスBT(ビスマレイミド トリアジン)上に銅箔からなる導電パターンを形成する。

次に、図2Aに示す工程で、平面視で四角形状のプリント基板4Oの実装面に 発光素子5を配列し、各発光素子5を接着剤によって機械的に取り付ける。

その後、図2日に示す工程で、発光素子5をダイボンディングした後、ワイヤボンディングにより、発光素子5のパッド電極(図示せず)と導電パターンとを電気的に接続する。続いて、図2Cに示す工程で、LCP(液晶ポリマー)、PPA(ポリフタルアミド)などの樹脂により成形された反射体60を接着剤などによってプリント基板40に貼り合わせる。図2Dに示すように、この反射体60の両端部には、断面が台形状の突条体61が形成されており、両端部の突条体

61の間には、断面が山形状の複数の突条体62が形成されている。さらに、図2Eに示す工程で、透明の樹脂封止材10を、プリント基板4と反射板6の傾斜面6a, 6aとの間に形成される凹部7に充填して発光素子5を封止する。つぎに、図2Fにおいて破線で示されているように、平面視で四角形状のプリント基板40を細長い角棒状になるようにダイシングを行う。

以上の工程を経て、図1Aに示される線状の光源体が形成される。その後、細長い角棒状のプリント基板4の端縁部と、両反射板6の傾斜面6a.6aの端縁部との間の部位に位置する各樹脂封止層の台形状の断面を鏡面化する。例えば、粒度が800番以上の研磨ブレードを選択し、回転スピードを20.000~30.000 rpmとすると共に、切削スピードを5mm/secとして鏡面化を行う。その他、研磨材によって鏡面化を行うようにしてもよい。

次に、図2Bに示すように、反射シート101によって、プリント基板4の実装面に隣接する端面(上面及び下面)から反射板6の傾斜面6a, 6aの先端部にかけての領域を覆う。

なお、第1の実施形態においては、図1Bに示すように、反射シート101によって、プリント基板4の実装面に隣接する端面(上面及び下面)から反射板6の傾斜面6a、6aの先端部にかけての領域を覆うようにしたが、図1Cに示すように、当該領域を銀やアルミニウムからなる蒸着膜12によって覆うようにしてもよい。この場合、スパッタ若しくは真空蒸着によって厚さ数μm程度の薄膜が形成される。そして、反射シート101と同様に、輝度の向上が図れる。また、鏡面化工程を行なってから、蒸着膜12を形成してもよい。

さらに、第1の実施形態においては、反射板6の傾斜面6a,6aを矩形状にすると共に、樹脂封止層の形状を台形柱状にしたが、図3Aに示すように、先端部が二等辺三角形状のブレード15によって、プリント基板4の裏側からダイシングして、反射板6の傾斜面6a,6aを台形状にすると共に、樹脂封止層の形状を台錐形状にしてもよい(図3B参照)。この場合、図3Cに示すように、図1B及びCの場合に比して、上下左右方向に広角に拡散されることになり、高輝度な幅広の線状の発光面が形成されることになる。また、反射板6の傾斜面6a,6aが台形状で、樹脂封止層の形状が台錐形状であっても、樹脂封止層の断面

13

の鏡面化、反射シート101の貼着、蒸着膜12の形成などはいずれも可能である。

- 第2の実施形態ー

本発明の第2の実施形態においては、ダイボンディングされた発光素子の主光取出し面、及び、発光素子がダイボンディングされた配線基板を、導光板の側面に平行に設置することで、導光板の光取込み効率を向上させている。しかも、二つの反射板を、発光素子の両側に、導光板の側面に向かうにしたがって開口面積が大きくなるように傾斜して配設して、導光板の側面の長手方向に沿って放出される発光素子の光を導光板に取り込むようにしている。さらに、配線基板、発光素子、二枚の反射板によって形成される凹部に樹脂封止材を充填し、該凹部における空気層を排除し、加えて、導光板の一方の発光面から配線基板までの領域を平板状の反射シートによって被覆すると共に、導光板の他方の発光面の端部から配線基板までの領域を帯状の反射シートによって被覆している。このような構造により、導光板の発光面の輝度の向上、及び、輝度の均一化を図っている。

図4は、本発明の第2の実施形態に係る面発光装置の構造を示す斜視図である。図5は、第2の実施形態における素子の実装部分を、導光板とプリント基板の取付け構造と共に示す要部の縦断面図である。図4及び図5において、図1~図3と同一符号であるものは同一もしくは相当する部材を示すものとする。

図4及び図5に示すように、第2の実施形態の面発光装置は、平面視矩形状の下反射シート1と、該下反射シート1の上面においてその一方の側端部を除く部位に貼着された平板状の導光板2と、下反射シート1の一方の側端部に、且つ、導光板2の側面に沿って、設けられた線状の光源部3と、線状の光源部3及び導光板2の上面、即ち発光面の端部を覆うように貼着された細長い帯状の上反射シート11とを備えている。

下反射シート1は、例えば、鏡面状のテープ、又は、白色などの光反射率の高い材料からなるテープ状のものである。下反射シート1によって、導光板2からプリント基板4までの領域、即ち、導光板2の一方の発光面からプリント基板4の下面までが覆われることになる。このため、線状の光源部3から下方向に放出する光が下反射シート1で反射されて導光板2の中に戻される。

導光板2は、例えば、アクリル樹脂やポリカーボネイト樹脂によって構成される、厚み0.3~1.0mmの透明の板であり、導光板2の上方には、発光面に対峙して液晶表示パネル(図示されていない)が設置されている。言い換えると、導光板2は、液晶表示パネルの下面に対峙して配置されている。

線状の光源部3は、その軸線が導光板2の側面に平行になるように設けられた配線基板としての細長い角棒状のプリント基板4と、導光板2の側面に対峙するプリント基板4の側面上において、導光板2の側面に沿って所定の間隔をおいて配置された発光素子5と、プリント基板4の側面上において各発光素子5の間に配置された、平面視で台形状の反射体6と、プリント基板4、発光素子5、反射体6との間に存在している、断面がほぼ台形状の凹部7を埋める樹脂封止層10とを備えている。

プリント基板 4 は、発光素子 5 をマトリックス状に実装した平板状のプリント基板から、導光板 2 の厚みに合わせてダイシングされたものである。このダイシングされたプリント基板 4 において、各発光素子 5 が横一列に並んでいる。このプリント基板 4 の厚さとほぼ同一であり、プリント基板 4 の厚さによって、面発光装置の厚さ寸法 A が決定される。本実施形態の構造では、発光素子 5 が、上記第 1 の従来技術のように、フレキシブル基板上に設けられているのではなく、下反射シート 1 の上に設けられているので、この厚さ寸法 A は、図 7 に示す面発光装置の厚さ寸法 A ′ に比して大幅に小さくなっている。さらに、プリント基板 4 の両端部から発光素子 5 に通電するための + 及び - の電極端子8 a 、8 b がそれぞれ導出されて、該両端子8 a 、8 b は、携帯電話などの機器側の回路(図示せず)に導通接続される。

各発光素子5は、例えば、GaN系化合物半導体を利用した白色発光のもので、透明のサファイア基板上にエピタキシャル成長されたn型層及びp型層のそれぞれの表面上に、n型電極及びp型電極が形成され、該両電極は、ワイヤ9によって、プリント基板4の配線パターンにダイボンディングされ、蛍光体を含有する透明樹脂で被覆された各発光素子5が電気的に直列接続されている。さらに、各発光素子5は、その主光取出し面が、導光板2の側面に対して平行するように並設され、しかも、並設された各発光素子5の横方向の光軸が同一直線状に位置

すると共に、導光板2の側面の長手方向の中心線と同一高さの位置で対峙している。

反射体 6 は、その両側の傾斜面 6 a , 6 a が反射板として発光素子 5 の両側方に位置し、導光板 2 の側面に向かうにしたがって開口面積が大きくなるように形成されており、各発光素子 5 の光が反射体 6 の傾斜面 6 a に反射され、且つ、拡散されながら導光板 2 の側面から入射することになる。したがって、各発光素子 5 の入射光が広角に拡散されて導光板 2 の側面から入射するため、導光板 2 において、輝度の乏しい各発光素子 5 の間においては、拡散された各発光素子 5 の入射光が重なり合うことで、線状の光源部 3 の輝度が均一になり、導光板 2 における面発光の輝度がほぼ均一になる。この反射体 6 の傾斜面 6 a の傾斜角度は、導光板 2 の輝度むらをなくすべく適宜調整可能である。

樹脂封止層10は、エポキシ樹脂などの透明の樹脂封止材が充填されて形成されている。そして、この樹脂封止材が、プリント基板4,発光素子5,反射体6の間に形成される凹部7に注入充填されると、凹部7の空気層は樹脂封止材によって排除されることになるので、発光素子5から導光板2への光の取込み効率がよくなる。

上反射シート11は、下反射シート1と実質的に同一の材質によって構成されており、導光板2の端部からプリント基板4までの領域、即ち導光板2における発光素子5側の端部、発光素子5の上方、反射板6の上面、プリント基板4の上面がそれぞれ覆われることになる。このため、下反射シート1及び上反射シート11によって、上下方向に放出される各発光素子5の光が、導光板2と線状の光源部3との隙間からの光の漏れがないように反射されることになり、各発光素子5からの光をほとんど余すことなく導光板2に入射できるようになっている。また、上反射シート11からプリント基板4が露出しておらず、上反射シート11の幅寸法Bが、光源部3の設置スペースの幅寸法となっているため、図7に示す面発光装置の光源部22の設置スペースの幅寸法B'に比して大幅に縮小されている。

次に、面発光装置の使用態様について説明する。プリント基板 4 の配線パターンを介して各発光素子 5 が通電されると、各発光素子 5 の半導体層の中の活性層

から光が放出される。活性層からの光は、発光素子5の主光取出し面、即ちワイヤ9をダイボンディングする電極が形成された面から放出される。

導光板2の側面に対して直交する方向に放出される光は、導光板2の中をそのまま進み、導光板2の側面に対して平行に放出される光は、両側の反射体6の傾斜面6a,6aで反射されて、導光板2に戻され、各発光素子5の主光取出し面から上下方向にそれぞれ放出される光は、上反射シート11及び下反射シート1によって反射されて導光板2に戻される。

このように、各発光素子5から放射される光が導光板2に取り込まれるので、 導光板2の発光面の輝度むらがなく、導光板2の発光面の輝度の均一化が図れる 。加えて、各発光素子5を樹脂封止することで、導光板2への光取込み効率が高 くなり、輝度が向上する。

次に、面発光装置の製造方法について説明する。まず、線状の光源部3では、プリント基板4として、例えば、白色のガラスBT(ビスマレイミド トリアジン)上に銅箔からなる導電パターンを形成する。そして、LCP(液晶ポリマー)、PPA(ポリフタルアミド)などの樹脂を用いて反射板(実施形態においては反射体6の傾斜面6a)を成形し、接着剤などによってプリント基板4の導電パターンの上に反射板を貼り合わせる。その後、プリント基板4の所定の位置に発光素子5を接着剤によって機械的に取り付ける。つぎに、発光素子5をダイボンディングして電気的に接続を行い、発光素子5を透明樹脂にて封止した後、導光板2の厚みに合わせてプリント基板4を角棒状にダイシングし、製品の分割を行う。

次に、平板状の下反射シート1の端部を除く部位に導光板2を貼着し、角棒状のプリント基板4、及び、各発光素子5の主光取出し面を導光板2の側面に対して平行するように設け、導光板2の一方の発光面からプリント基板4までの領域を平板状の下反射シート1によって被覆すると共に、導光板2の他方の発光面の端部からプリント基板4までの領域を帯状の上反射シート11によって被覆する

なお、第2の実施形態においては、光を反射する機能を発揮する部分として、 平面視で台形状の反射体6の傾斜面6a,6aを利用したが、このような機能を 有する部材の構造は、図示されている構造に限定されるものではなく、平面視で 三角形状の反射体の傾斜面を利用してもよく、細長く切断加工された反射板を用 いてもよい。また、いずれの反射板も角度調整可能な構成にするのが好ましい。 要するに、反射板の形状や角度は、各発光素子5の光を効率よく反射して、隣り 合う発光素子5,5の光が重なり合う領域を大きくすることで、導光板2におい て、光の乏しい各発光素子5,5の間の輝度を補完し、導光板2の面発光の輝度 をほぼ均一にできればよい。

また、光透過性の樹脂封止層10に、ガラスビーズなどの光分散材を混合させ、導光板2の輝度特性を高めることも可能である。

さらに、第2の実施形態では、帯状の上反射シート11によって導光板2のほぼ端部からプリント基板4までの領域を覆うようにしたが、導光板2の周縁部からプリント基板4までの領域をコ字形状、又は、枠状の上反射シートによって覆うようにしてもよい。

以上説明したように、第2の実施形態によれば、発光素子をダイボンディング して配線基板に実装すると共に、ダイボンディングされた発光素子の主光取出し 面を導光板の側面に対して平行になるようにしたため、導光板への光取込み効率 を向上することができる効果がある。

また、発光素子の主光取出し面の中心の位置と、導光板の側面の長手方向の中心線の位置とを同じ高さになるように設け、最も輝度が高いとされる発光素子からの光を導光板の側面から取り込むようにしたので、導光板の発光面の輝度を向上させるのに有効である。

さらに、配線基板を導光板の厚みに合わせて角棒状に加工すると共に、配線基板の軸線を導光板の側面に対して平行になるように配置すれば、全体の薄型化、 及び、全体の小型化を図るのに効果的である。

加えて、二つの反射板を、発光素子の両側に、導光板の側面に向かうにしたがって開口面積が大きくなるように傾斜して配設し、導光板の側面の長手方向に沿って放出される発光素子の光を導光板に取り込むようにしているため、反射板によって、光源部の配光特性を自由に変えることができ、導光板の輝度むらをなくすことができると共に、導光板の輝度を高くすることができる。

そして、配線基板、発光素子、及び二つの反射板の間に形成されている凹部に 光透過性の樹脂封止材を充填し、該凹部において空気層をなくし、光の取込み効 率をさらに向上するようにしたので、輝度が向上する。

さらに、導光板の一方の発光面から配線基板までの領域を平板状の反射シートによって被覆すると共に、導光板の他方の発光面のほぼ端部から配線基板までの領域、又は、導光板の他方の発光面の周縁部から配線基板までの領域を反射シートによって被覆し、導光板の両発光面に対して直交する方向に放出される発光素子の光を、二つの反射シートによって導光板に戻すようにしているので、導光板の発光面の輝度の向上を有効に図ることができる。

産業上の利用可能性

本発明の線状光源装置及び面発光装置は、例えば、小型化及び薄型化された携 帯電話やディジタルカメラなどの液晶表示パネルのバックライトとして利用する ことができ、高輝度で且つ輝度むらの少ない表示部となり得る。

請求の範囲

1. 実装面を有する角棒状の配線基板と、

上記配線基板の上記実装面上に、長手方向に沿って所定の間隔をおいて配設されてダイボンディングされた複数の発光素子と、

上記配線基板の実装面上に、上記各発光素子の両側に、且つ、各発光素子と交 互に位置するように配置された複数の反射板とを備え、

上記各反射板は、上記発光素子を挟んで相対向する対向面を有しており、

上記各反射板の上記対向面は、各発光素子の出射方向に向かうにしたがって開口面積が大きくなるように傾斜している、線状光源装置。

2. 請求項1の線状光源装置において、

上記各反射板の上記対向面の形状が、矩形状又は台形状のいずれかである.線 状光源装置。

3. 請求項1又は2の線状光源装置において、

光透過性の樹脂封止材を、上記配線基板の実装面と、上記発光素子と、その両側の反射板の対向面との間に形成される各凹部に充填してなる樹脂封止層をさらに備えている、線状光源装置。

4. 請求項3の線状光源装置において、

上記各樹脂封止層において、上記配線基板と上記各反射板とに亘る端面が鏡面 化されている、線状光源装置。

5.請求項3又は4の線状光源装置において、

上記各樹脂封止層の上記各反射板の対向面の間に位置する部分の端面が上記各反射板の端面と実質的に1つの平面を構成している、線状光源装置。

6. 請求項5又は6の線状光源装置において、

上記配線基板の実装面に隣接する長手方向の両端面から上記各反射板の対向面

の先端部に亘る領域に設けられ、反射シート又は蒸着膜からなる反射部材をさら に備えている、線状光源装置。

7. 配線基板の実装面上に、発光素子を所定の間隔をおいて配列してダイボンディングする工程(a)と、

上記配線基板の実装面上に、上記発光素子の出射方向に向かうにしたがって開口面積が大きくなるように傾斜した対向面を有する反射板を、各発光素子の両側に配置する工程(b)と、

上記工程(a)及び(b)の後で、光透過性の樹脂封止材を、上記配線基板の実装面と、発光素子と、反射板の傾斜面との間に形成される凹部に充填する工程(c)と、

上記工程(c)の後で、上記反射板が上記各発光素子の両側に、且つ、各発光素子と交互に位置するようにダイシングすることにより角棒状の光源装置を切り出す工程(d)と

を含む線状光源装置の製造方法。

8. 請求項フの線状光源装置の製造方法において、

上記工程(d)では、先端の断面が二等辺三角形状のブレードによって上記配線基板の裏側からダイシングを行なって、上記角棒状の光源装置の断面を台形状に加工する、線状光源装置の製造方法。

9.

配線基板と、該配線基板に導通接続された発光素子と、該発光素子からの光を 取り込んで略全面を発光面とする導光板とを備え、

上記発光素子は、上記配線基板にダイボンディングされ、さらに、発光素子の 主光取出し面が上記導光板の側面に対して平行に取り付けられている。面発光装置。

10.請求項9の面発光装置において、

上記発光素子の主光取出し面の中心の位置と、導光板の側面の長手方向の中心線の位置とが同一高さである、面発光装置。

11. 請求項9又は10の面発光装置において、

上記配線基板は、上記導光板の厚みに合わせて角棒状に加工されており、

上記配線基板の長手方向の軸線が上記導光板の側面に対して平行である, 面発 光装置。

FIG. 1A

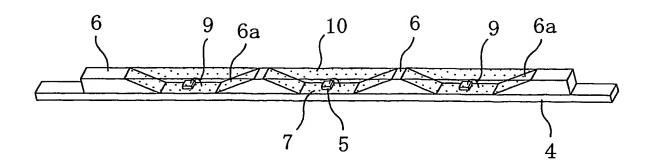


FIG. 1B

101

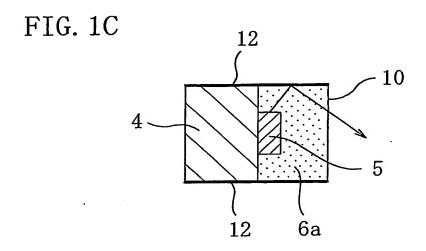
101

101

5

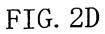
101

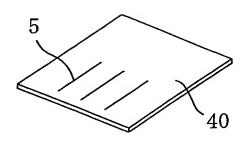
6a



2/6

FIG. 2A





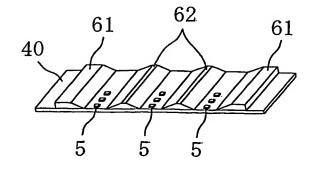
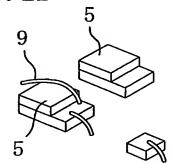


FIG. 2B

FIG. 2E



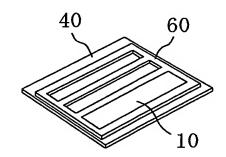
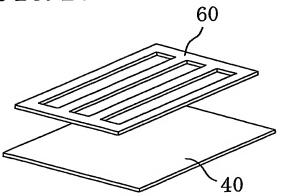
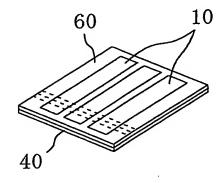


FIG. 2C

FIG. 2F





PCT/JP2004/000210

3/6

FIG. 3A

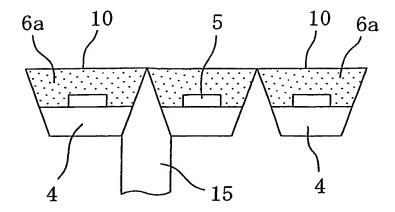


FIG. 3B

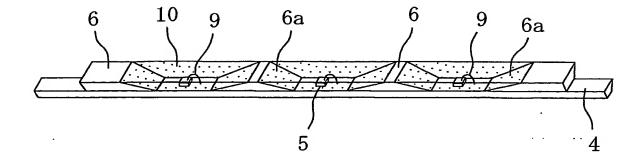
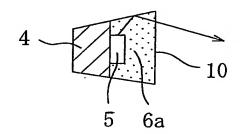


FIG. 3C





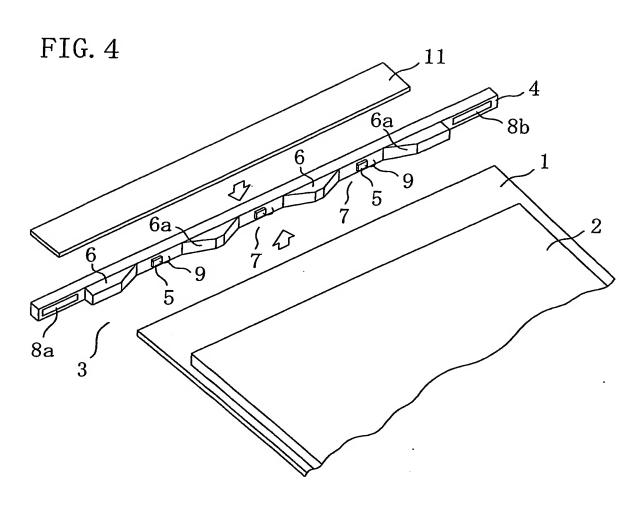
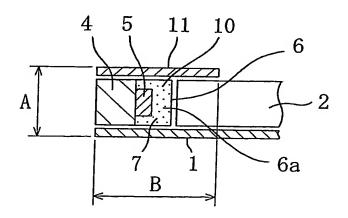


FIG. 5





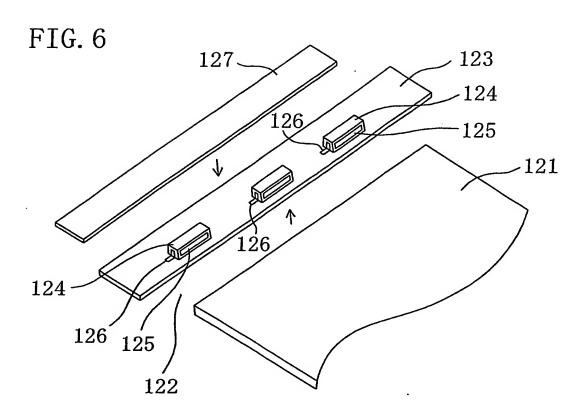
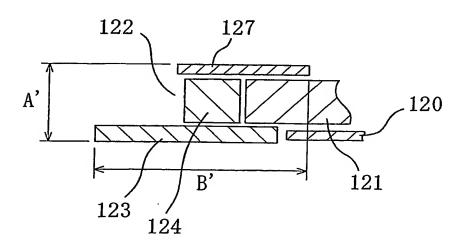


FIG. 7



6/6 .

FIG. 8

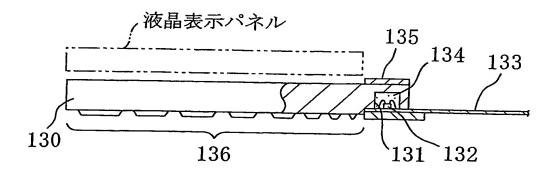
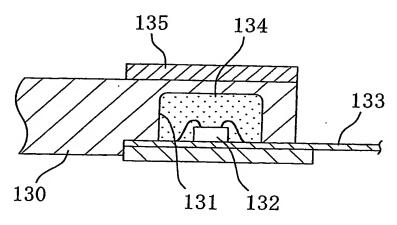


FIG. 9



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

		PCT/J:	P2004/000210	
A. CLASSIFIC	CATION OF SUBJECT MATTER			
Int.Cl ⁷ H01L33/00				
According to In	ternational Patent Classification (IPC) or to both nation	nal classification and IPC		
B. FIELDS SI				
Minimum docur	mentation searched (classification system followed by c H01L33/00	classification symbols)		
1110.02	H01H33/00			
	•	•	•	
Documentation :	searched other than minimum documentation to the ext	tent that such documents are included in	the fields searched	
Jitsuyo	Shinan Koho 1922-1996 To	oroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004	
Kokai J	itsuyo Shinan Koho 1971-2004 J	itsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004	
Electronic data t	base consulted during the international search (name of	data base and, where practicable, search	terms used)	
	•			
C. DOCUMEN	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
х	JP 5-38627 U (Sanken Electri	ic Co., Ltd.),	9-11	
Y	25 May, 1993 (25.05.93),		1-7	
	Full text; all drawings (Family: none)			
	-			
X	JP 2000-138397 A (Nichia Che	emical Industries, .	9-11	
Y	Ltd.), 16 May, 2000 (16.05.00),		1-7	
	Full text; all drawings	•		
	(Family: none)			
Y	 JP 63-159859 U (Nippon Denyo	o Kabushiki Kaisha),	1-7,9-11	
	19 October, 1988 (19.10.88),	,	1 - 1,2	
	Full text; all drawings	•		
	(Family: none)			
× Further do	ocuments are listed in the continuation of Box C.		<u> </u>	
		See patent family annex.		
"A" document de	gories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered	"T" later document published after the in date and not in conflict with the appl	lication but cited to understand	
-	icular relevance cation or patent but published on or after the international	the principle or theory underlying the "X" document of particular relevance; the		
filing date		considered novel or cannot be constep when the document is taken alor	sidered to involve an inventive	
cited to esta	hich may throw doubts on priority claim(s) or which is ablish the publication date of another citation or other	"Y" document of particular relevance: the	claimed invention cannot be	
•	on (as specified) ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	considered to involve an inventive combined with one or more other such	e step when the document is ch documents. such combination	
"P" document pu	ublished prior to the international filing date but later than	being obvious to a person skilled in t	the art	
the priority date claimed "&" document member of the same patent family				
Date of the actual	Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report			
01 Aprı	11, 2004 (01.04.04)	20 April, 2004 (20	0.04.04)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer Japanese Patent Office				
Facsimile No.		Telephone No		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/000210

Continuation	a). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	T	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
X Y	JP 2-37784 A (Sanyo Electric Co., Ltd.), 07 February, 1990 (07.02.90), Full text; all drawings (Family: none)	1-2 3-6,7,9-11	
Υ .	JP 7-199829 A (Harison Denki Kabushiki Kaisha), 04 August, 1995 (04.08.95), Full text; all drawings (Family: none)	1-7,9-11	
Y	JP 63-24858 U (Rohm Co., Ltd.), 18 February, 1988 (18.02.88), Full text; all drawings (Family: none)	1-7,9-11	
		1 .	
	·		
	·		
	·		
	n i		
		·	
	·		
	10 (continuation of record cheet) (Innum; 2004)	J ·	

Δ	発明の属する分野の分類	(国際特許分類	(IPC))
A .	96 17 1 V 2 17 18 9 6 1 1 1 1 1 1 V 2 1 1 1 1 1 1		\

Int. Cl' H01L 33/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H01L 33/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2004年

日本国登録実用新案公報

1994-2004年

日本国実用新案登録公報

1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X Y	JP 5-38627 U(サンケン電気株式会社), 1993. 05. 25, 全文,全図(ファミリーなし)	9-11 1-7	
X Y	JP 2000-138397 A(日亜化学工業株式会社),2000.05.16, 全文,全図(ファミリーなし)	9-11 1-7.	

x C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

C (続き). 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*			関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 63-159859 U(日本デンヨー株式会社) 全文,全図(ファミリーなし)	, 1988. 10. 19,	1-7, 9-11
X Y	JP 2-37784 A(三洋電機株式会社),1990. 全文,全図(ファミリーなし)	02. 07,	1-2 3-6, 7, 9-11
Y	JP 7-199829 A(ハリソン電機株式会社), 全文,全図(ファミリーなし)	1995. 08. 04,	1-7, 9-11
Y.	JP 63-24858 U(ローム株式会社),1988.0 全文,全図(ファミリーなし)	2. 18,	1-7, 9-11
			,
	•		·